

### ● 铭奋牌 FAIRCOOL 好力酷系列

FAIRCOOL系列导热硅脂系用于电子装置中的导热材料，具有优良的导热性能。本系列产品的粘度较低，可以使需冷却的电子元件表面和散热器之间紧密接触，减小热阻，可快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。FAIRCOOL系列导热硅脂不会交联，所以在电子装配过程中如有改动或更换散热器情况发生本产品具有易操作的特点。

本产品除具有高热导性之外，使用时也不产生应力，在-50至200℃下稳定性高，并且有极好的耐气候，耐辐射以及优良的介电性能。

这六种产品广泛地用于微处理器、内存模块、高速缓冲存储器、密封的集成芯片、DC/DC转换器、IGBTs及其他功率模块、功率半导体、固态继电器和桥型整流器等领域。

产品	基材	外观	粘度 cps	导热率 W/m·k	密度 g/cm <sup>3</sup>	挥发分 %	体积电阻 Ω·cm	介电强度 kv/mm	持续使用温度
FAIRCOOL SG-104	硅树脂	半透明液状	123,000	0.42	2.56	≤0.05	≥2.3×10 <sup>10</sup>	≥14	-50℃至+200℃
FAIRCOOL SG-110	硅树脂	白色液状	200,000	1.0	2.4	≤2.0	≥2×10 <sup>10</sup>	≥12	-50℃至+200℃
FAIRCOOL SG-115	硅树脂	白色液状	160,000	1.5	2.5	≤2.0	≥5×10 <sup>10</sup>	≥12	-50℃至+200℃
FAIRCOOL SG-119	硅树脂	白色液状	200,000	1.9	2.75	≤2.0	≥5×10 <sup>10</sup>	≥12	-50℃至+200℃
FAIRCOOL SG-126	硅树脂	白色液状	300,000	2.6	1.45	≤2.0	≥5×10 <sup>10</sup>	≥12	-50℃至+200℃
FAIRCOOL SG-144	硅树脂	白色液状	1600,000	4.4	1.45	≤2.0	≥5×10 <sup>10</sup>	≥12	-50℃至+200℃
FAIRCOOL SG-150	硅树脂	白色液状	200,000	5.0	1.50	≤2.0	≥5×10 <sup>10</sup>	≥12	-50℃至+200℃



FLYER-20080912-2